

## 富士 産業用IGBT モジュール ソルダーピンタイプ

EconoPIM™ (M711, M712, M719, M720)

EconoPACK™ (M633, M636, M668, M669, M1203)

## マウンティングインストラクション

EconoPIM™ and EconoPACK™ are registered trademark of Infineon Technologies AG, Germany.

## CONTENTS

1. 適用範囲	2
2. 対象型式	3
3. ヒートシンクへの実装	5
3-1. ヒートシンクの表面形状	5
3-2. サーマルグリースの塗布	6
3-3. ヒートシンクへのネジ止め	7
4. プリント基板への実装	8
4-1. プリント基板へのはんだ付け	8
4-2. プリント基板へのネジ止め	9
5. 注意事項	11
6. 保管・運搬上の注意事項	12

## 1. 適用範囲

本インストラクションは、富士電機半導体製品のEconoPIM™、EconoPACK™ソルターピンタイプ製品を安全に搭載、使用方法について説明します。

対象型式については2. 対象型式を確認して下さい。

製品の取り扱いにおいては、本資料の記載内容に加えて、対象製品の納入仕様書のWarning、Cautionを確認願います。

EconoPIM™ and EconoPACK™ are registered trademark of Infineon Technologies AG, Germany.

## 2. 対象型式

本インストラクションの対象型式は次の通りです。

表1 EconoPIM™ (PIM, コンバータ部、ブレーキ部内蔵)

		650V (Xシリーズ)	600V (Vシリーズ)	1200V (Xシリーズ)	1200V (Vシリーズ)
M711 (Aタイプ)	25A				7MBR25VA120-50
	35A				7MBR35VA120-50
	50A		7MBR50VA060-50		
M712 (Bタイプ)	35A				7MBR35VB120-50
	50A				7MBR50VB120-50
	75A		7MBR75VB060-50		7MBR75VB120-50
	100A		7MBR100VB060-50		
M719 (Mタイプ)	25A				7MBR25VM120-50
	35A			7MBR35XMA120-50	7MBR35VM120-50
	50A	7MBR50XMA065-50		7MBR50XMA120-50	7MBR50VM120-50
	75A	7MBR75XMA065-50		7MBR75XME120-50	
M720 (Nタイプ)	50A				7MBR50VN120-50
	75A	7MBR75XNA065-50		7MBR75XNA120-50	7MBR75VN120-50
	100A	7MBR100XNA065-50		7MBR100XNA120-50	7MBR100VN120-50
	150A	7MBR150XNA065-50		7MBR150XNE120-50	7MBR150VN120-50
M719 (Pタイプ)	25A				7MBR25VP120-50
	35A			7MBR35XPA120-50	7MBR35VP120-50
	50A	7MBR50XPA065-50	7MBR50VP060-50	7MBR50XPA120-50 7MBR50XPE120-50	7MBR50VP120-50
	75A	7MBR75XPA065-50	7MBR75VP060-50	7MBR75XPE120-50	
	100A	7MBR100XPE065-50	7MBR100VP060-50		
M720 (Rタイプ)	50A				7MBR50VR120-50
	75A			7MBR75XRA120-50 7MBR75XRE120-50	7MBR75VR120-50
	100A	7MBR100XRA065-50	7MBR100VR060-50	7MBR100XRA120-50 7MBR100XRE120-50	7MBR100VR120-50
	150A	7MBR150XRA065-50 7MBR150XRE065-50	7MBR150VR060-50	7MBR150XRE120-50	7MBR150VR120-50

EconoPIM™ and EconoPACK™ are registered trademark of Infineon Technologies AG, Germany.

**表2 EconoPACK™ (6個組)**

		650V (Xシリーズ)	600V (Vシリーズ)	1200V (Xシリーズ)	1200V (Vシリーズ)
M636(V) M669(X)	50A		6MBI50VA-060-50		6MBI50VA-120-50
	75A		6MBI75VA-060-50		6MBI75VA-120-50
	100A		6MBI100VA-060-50	6MBI100XAE120-50	6MBI100VA-120-50
M633(V) M668(X)	100A			6MBI100XBA120-50	6MBI100VB-120-50
	150A		6MBI150VB-060-50	6MBI150XBA120-50	6MBI150VB-120-50
	180A				6MBI180VB-120-50 6MBI180VB-120-55
	200A			6MBI200XBA120-50 6MBI200XBE120-50	
	250A			6MBI250XRBE120-50	

**表3 EconoPACK™ (12個組)**

		650V (Xシリーズ)	600V (Vシリーズ)	1200V (Xシリーズ)	1200V (Vシリーズ)
M1203	50A				12MBI50VN-120-50
	75A				12MBI75VN-120-50
	100A				12MBI100VN-120-50

EconoPIM™ and EconoPACK™ are registered trademark of Infineon Technologies AG, Germany.

### 3. ヒートシンクへの実装

#### 3-1. ヒートシンクの表面形状

モジュールを実装するヒートシンクは下記の表面条件を満たすように設計して下さい。粗さや平面度が条件を満たさない場合、接触熱抵抗の増加やパッケージ割れによる絶縁破壊などを起こす可能性があります。

1. ヒートシンクの表面粗さ( $R_z$ )は、 $10\mu\text{m}$ 以下となるようにして下さい。
2. ヒートシンクの表面平面度は、ネジ取付位置間で穴の中心間を結んだ直線を基準面とし、2点間の距離 $100\text{mm}$ あたり、絶対値で $50\mu\text{m}$ 以下となるようにして下さい。なお、ヒートシンクが凸形状の場合を「+」(プラス)、凹形状の場合を「-」(マイナス)と定義しています。ヒートシンクの形状が+側、-側の凹凸形状を有する場合は、+側最大値と、-側最小値の差で $50\mu\text{m}$ 以下を推奨いたします。

\* 2つのネジランプを含むモジュール実装エリア内において、平坦度は上記を満たして下さい。

図1にヒートシンクの表面粗さと平面度の定義について記します。

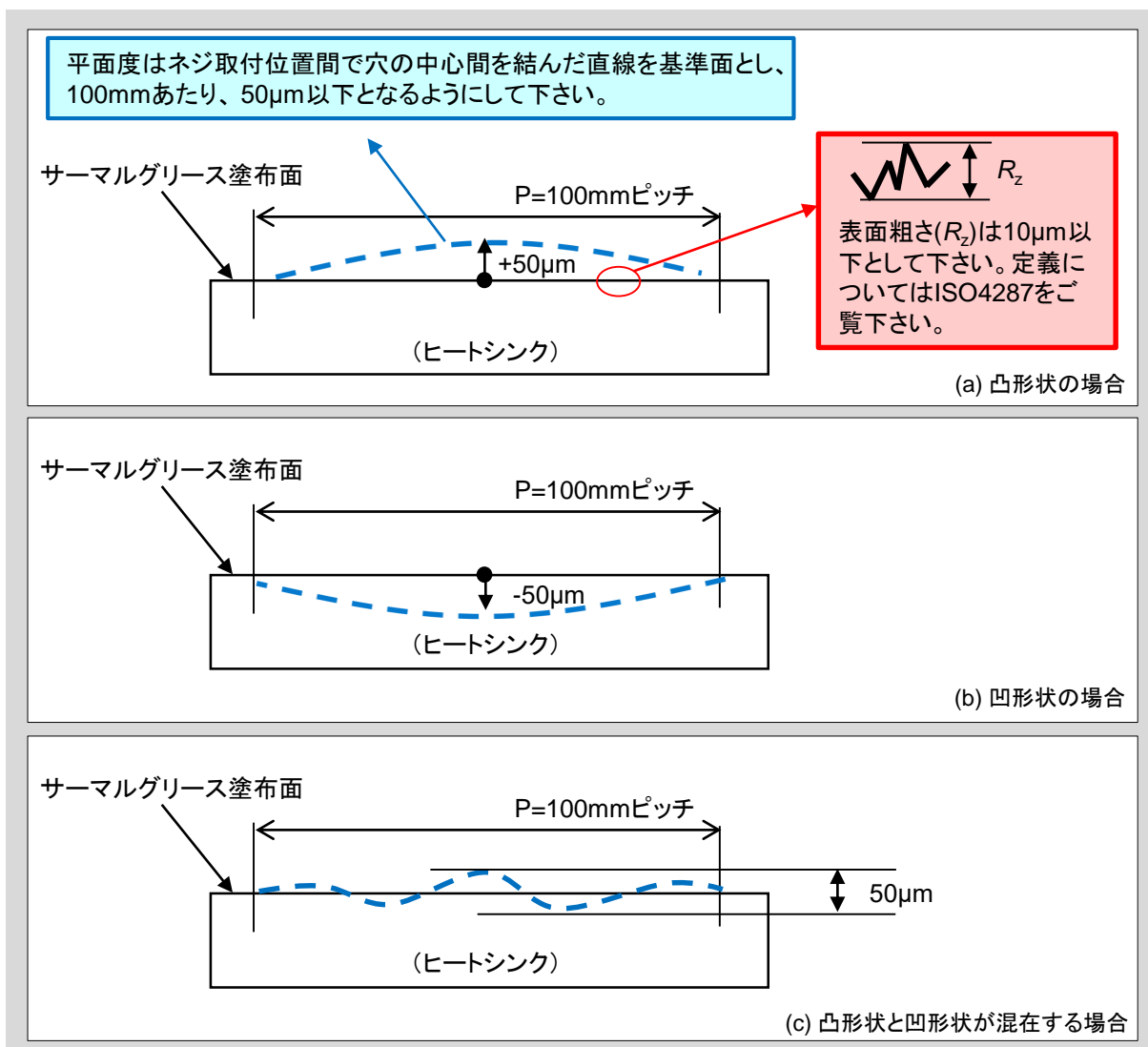


図1 ヒートシンクの表面粗さ及び平面度

### 3-2. サーマルグリースの塗布

モジュールからヒートシンクへの放熱性を確保するためにモジュール取り付け面とヒートシンクとの間にサーマルグリースを塗布して下さい。

サーマルグリース塗布量の不足、塗布方法が適正でない場合、サーマルグリースが十分に取付け面全体に広がらず、放熱悪化による熱破壊に繋がる事があります。サーマルグリースを塗布する際には、モジュール全面のサーマルグリースの拡がりだけでなく、モジュールの放熱状態をお客様にてご確認をお願いします。実装した後にモジュールを取りはずすとサーマルグリースの拡がり具合を確認する事が出来ます。

表2に推奨のサーマルグリース仕様、厚さを示します。サーマルグリースの必要量(重さ)は厚さが均一であると仮定した場合に次式から算出することができます。

$$\begin{array}{l} \text{サーマルグリース} \\ \text{の重さ(g)} \times 10^4 \end{array} = \begin{array}{l} \text{サーマルグリース} \\ \text{の厚さ}(\mu\text{m}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{モジュールの} \\ \text{ベース面積}(\text{cm}^2) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{サーマルグリース} \\ \text{の密度}(\text{g}/\text{cm}^3) \end{array}$$

また塗布方法については、適切な厚さを管理するためにステンシル工法を推奨します。(図2) 推奨のステンシルマスクパターンは、弊社の営業担当までご要望いただければ提供可能です。

また、サーマルグリースの種類・塗布方法によっては、高温動作時や温度サイクルでサーマルグリースの劣化や枯渇が発生し、製品寿命が低下する可能性があります。サーマルグリースの選定と塗布方法には十分留意してご使用下さい。

表4 サーマルグリースの推奨仕様

	単位	推奨値
稠度 (typ.)	-	>= 340
熱伝導率	W/m·K	>= 1
厚さ	μm	100+/-30

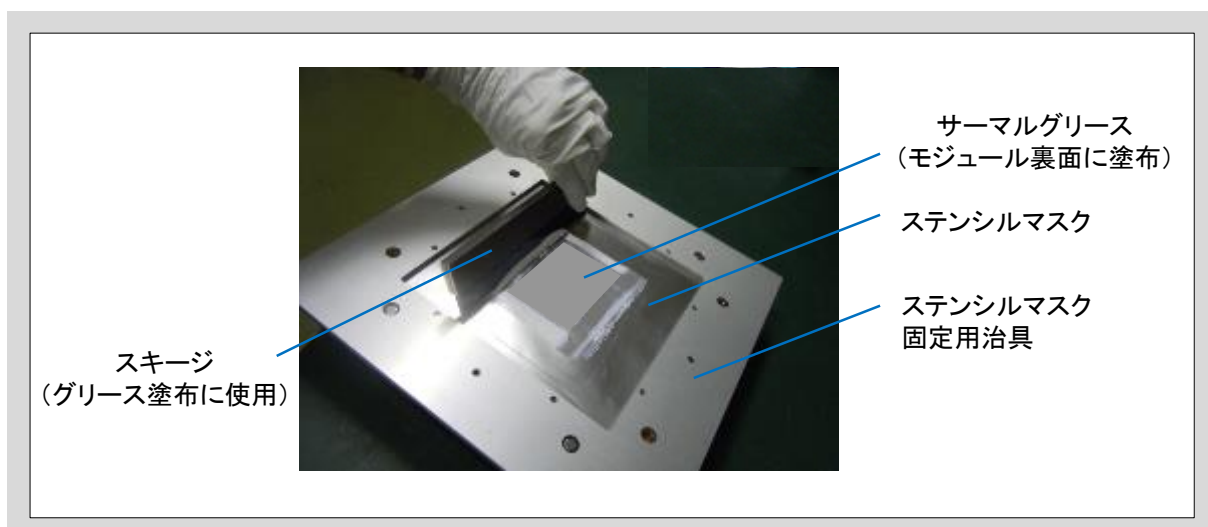
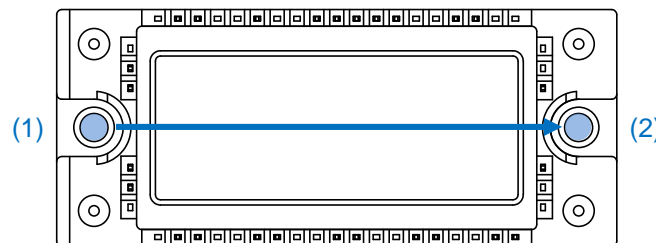


図2 サーマルグリース塗布の様子

### 3-3. ヒートシンクへのネジ止め

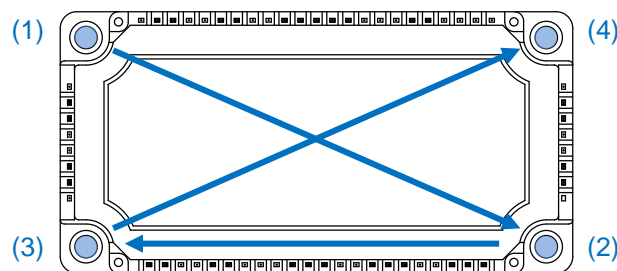
モジュールをヒートシンクへ実装する際の、ネジ締め方法について示します。

1. モジュールとヒートシンクの固定に使用するネジは、M5ネジを使用して下さい。
2. 均等の力で製品を固定するために、まず 図3に示す順序で0.5N・mで仮締めを行います。
3. 次に、仮締めと同じ順序で本締めを実施して下さい。本締めトルクの大きさは最大定格の範囲内として下さい。



	ネジ締めトルク	ネジ締めの順番
仮締め	0.5N・m	(1)→(2)
本締め	Vseries: 2.5~3.5N・m Xseries: 2.5~6.0N・m	(1)→(2)

(a) ネジ締めトルク及びネジ締め順序 (M711, M719, M636, M669の場合)



	ネジ締めトルク	ネジ締めの順番
仮締め	0.5N・m	(1)→(2)→(3)→(4)
本締め	Vseries: 2.5~3.5N・m Xseries: 2.5~6.0N・m	(1)→(2)→(3)→(4)

(b) ネジ締めトルク及びネジ締め順序 (M712, M720, M633, M668, M1203の場合)

図3 ネジ締めトルク及びネジ締め順序



## 4. プリント基板への実装

### 4-1. プリント基板へのはんだ付け

製品をプリント基板(以下PCB)へ実装する際の、推奨はんだ付け条件について示します。

端子温度:  $245 \pm 5^{\circ}\text{C}$

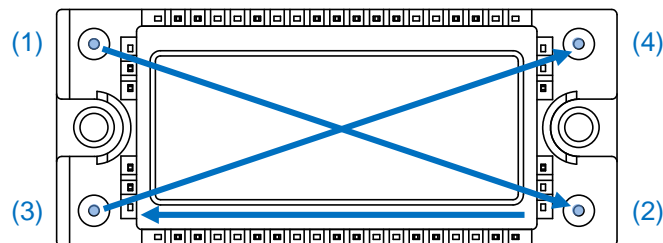
時間:  $5 \pm 0.5$ 秒

但し、弊社推奨はんだ付け温度の定義は“端子温度”となりますので、はんだ付け装置の設定温度とは異なります。ご使用のPCBの熱容量に適したはんだ付け装置の温度を設定して下さい。また、はんだ付け時には製品端子根本の樹脂部温度が $260^{\circ}\text{C}$ 以下であることをご確認下さい。

#### 4-2. プリント基板へのネジ止め

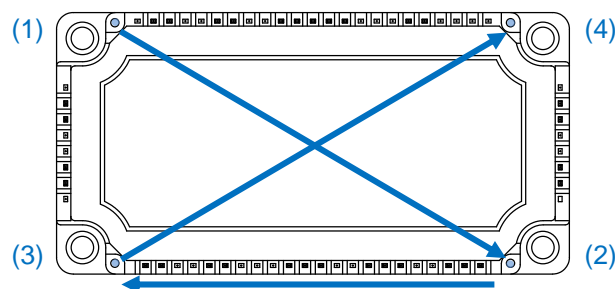
モジュールをPCBへ実装する際の、ネジ締め方法について示します。

1. モジュールとPCBの固定に使用するネジは、M2.5セルフタッピングネジを使用して下さい。
2. 均等の力でモジュールを固定するために、まず図4に示す順序でネジがまっすぐ入るように仮締めを行います。
3. 次に、仮締めと同じ順序で本締めを実施して下さい。本締めトルクの大きさは0.4~0.5N・mの範囲内として下さい。



	ネジ締めトルク	ネジ締めの順番
仮締め	ネジがまっすぐ入るように行う	(1)→(2)→(3)→(4)
本締め	0.4~0.5N・m	(1)→(2)→(3)→(4)

(a) ネジ締めトルク及びネジ締め順序 (M711, M719, M636, M669の場合)



	ネジ締めトルク	ネジ締めの順番
仮締め	ネジがまっすぐ入るように行う	(1)→(2)→(3)→(4)
本締め	0.4~0.5N・m	(1)→(2)→(3)→(4)

(b) ネジ締めトルク及びネジ締め順序 (M712, M720, M633, M668, M1203の場合)

図4 ネジ締めトルク及びネジ締め順序

4. モジュールとPCBの固定に使用するネジは、図5に示す様に、直径が2.4~2.6mm、長さはPCBの下面から7.0~10.0mmとなるネジをご使用下さい。
5. 手動でのネジ締めを推奨いたします。電動ドライバーや自動でネジ締めを行う場合は、機械的損傷を避けるため、ドライバーの選定や実装工程の各パラメータの最適化を行い、モジュールに損傷が無いことをご確認下さい。電動ドライバーや自動でネジ締めを行う場合、回転速度が300rpmを超えないようにご注意下さい。ネジ締めの悪い例を図6に示します。

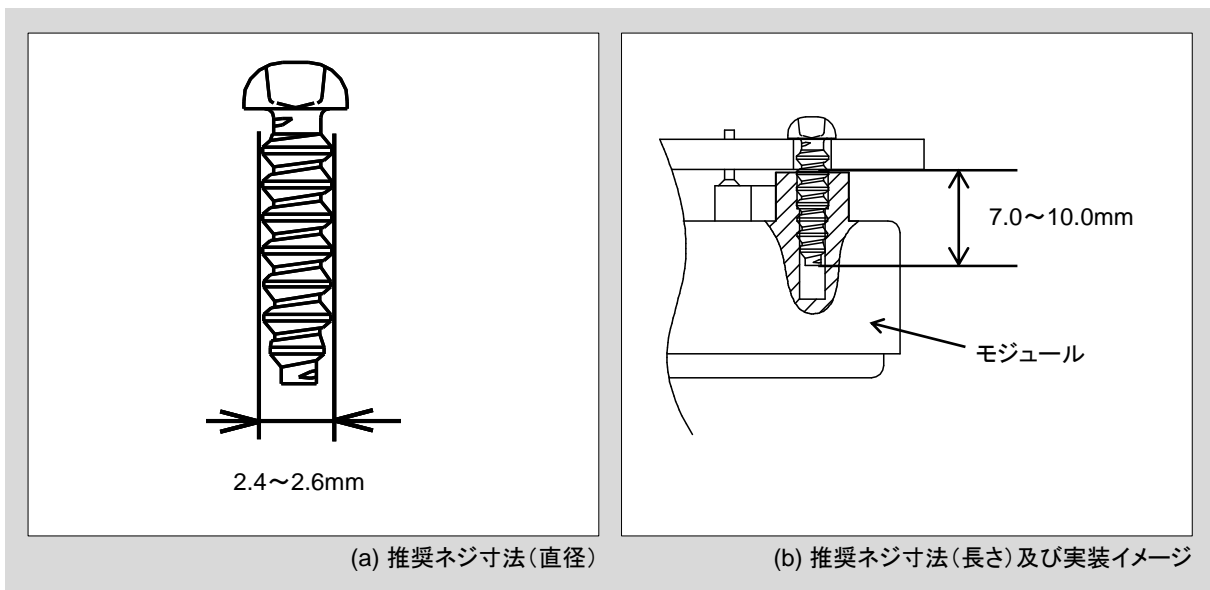


図5 推奨ネジの寸法及び実装イメージ

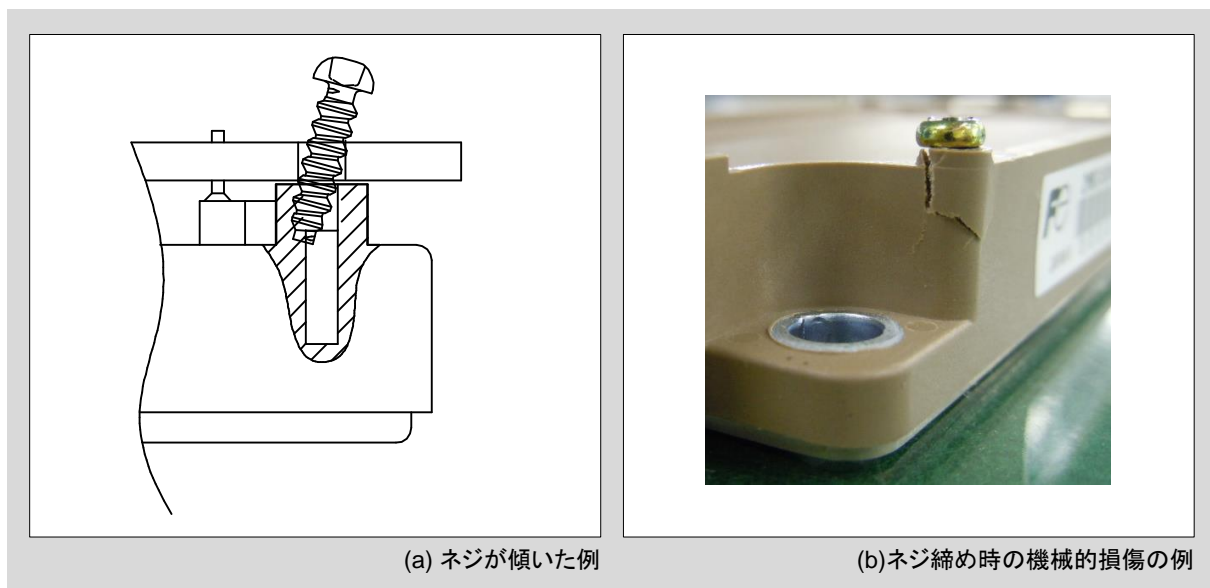


図6 ネジ締めの悪い例

## 5. 注意事項

- (1)使用するプリント基板が不適切な場合、端子の温度が保存温度以上になることがあります。端子も保存温度範囲内で御使用下さい。
- (2)本マウンティングインストラクション記載の許容値よりも長いネジなどを挿入した場合は製品が破損し、地絡、絶縁不良が発生する場合があります、その場合、富士電機は責任を負いません。
- (3)酸・アルカリ・有機物・腐食性ガス(硫化水素、亜硫酸ガス等)・腐食性の液体(切削液等)を含む環境下では製品に酸化や腐食が生じ接触不良・断線・短絡・地絡等、故障の原因となりますのでご使用は避けて下さい。万一短絡・地絡等が発生すると、副次的に発煙・発火・破裂の恐れが想定されます。これら腐食性物質を含む条件下で使用された場合、条件(温度・湿度・濃度等)によらず富士電機は責任を負いません。
- (4)製品は粉塵の発生する環境下での使用を想定して設計されておりません。粉塵が発生する環境で使用された場合、ヒートシンクが目詰まりによる放熱性の悪化や、端子間のリークや沿面放電による短絡・地絡が発生する場合があります。(粉塵が繊維などの絶縁物であっても、吸湿する事でリークが生じる場合があります。)
- (5)本製品をプリント基板に圧入する際、製品と圧入治具の間に異物があると、製品の絶縁基板がダメージを受けて絶縁機能の損傷を起こす可能性があります。そのため、圧入時には異物に対する対策を実施して下さい。

本インストラクションには全てのアプリケーションや実装条件について記載しておりません。従って、お客様にて、実際の使用条件において評価を行い、機械的特性、電気的特性、熱的特性、寿命等を確認してください。

本インストラクションに記載してある応用例は、富士電機の半導体製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本インストラクションによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

## 6. 保管・運搬上の注意事項

### 6.1 保管

- (1) 製品の保管場所の温度は5～35℃、湿度は45～75%が望ましいです。本保存条件下で、製造から1年以上経過した場合は端子半田付け性に十分注意して下さい。
- (2) 腐食性ガスを発生する場所や塵埃の多いところは避けて下さい。
- (3) 急激な温度変化のある場所では製品表面に結露が起こることがあります。このような環境を避け、温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- (4) 保管時は製品に外力または荷重がかからないようにして下さい。特に積み重ねた状態では思わぬ荷重がかかることがあります。また、重量物を製品の上に乗せないで下さい。
- (5) 製品の端子は未加工の状態でも保管して下さい。端子加工後に保管すると、錆などの発生によって製品実装時に半田付不良となることがあります。
- (6) 製品を仮置きなどする時の容器は静電気を帯びにくいものを選定して下さい。

### 6.2 運搬

- (1) 製品の運搬時に衝撃を与えたり、落下させたりしないで下さい。
- (2) 多数の製品を箱に入れて運搬する時は、接触電極面等を傷つけないようにやわらかいスペーサを製品相互間に入れて下さい。

## 注意

このマウンティングインストラクションの内容(製品の仕様、特性、データ、材料、構造など)は2022年10月現在のものです。この内容は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このインストラクションに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データをご確認下さい。